



**DISCOMP**  
ELECTRONIQUE

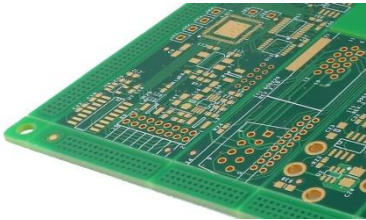
# CIRCUITS IMPRIMÉS



CID  
Certified Interconnect Designer

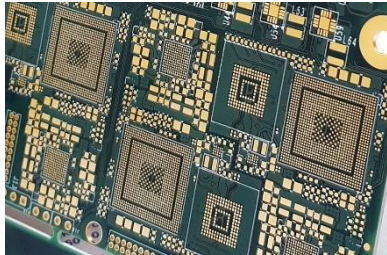
**DISCOMP ELECTRONIQUE, votre partenaire pour la réalisation de vos circuits imprimés.**

- **Un accompagnement technique dans la réalisation de vos projets.**
- **Maîtrise / Services / Ecoute & Réactivité**



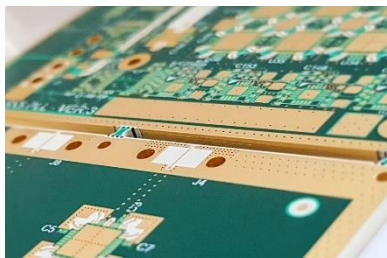
**FR4, FR4 HTg, SMI, Téflon, Aluminium composite et substrats céramique :**

**Circuit simple face, double face trous métallisés, multicouches 4 à 12 couches.**



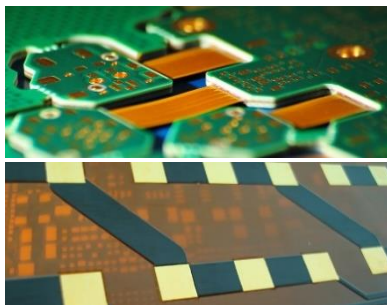
**HDI (Circuit Haute Densité d'Interconnexion) :**

**Avec une épaisseur finale de carte allant de 0,1 à 5,0 mm et un maximum de 40 couches sur des empilages complexes. Via enterrés, via borgnes, MicroVia, Microvia étagé, MicroVia skipped.**



**Hautes Fréquences :**

**Rogers série 4000 et 3000 au Megtron 6 et Nelco pour fabriquer des cartes haute fréquence complexes avec des exigences d'impédance et des tolérances étroites.**



**Flex-Rigide & Circuit Flex :**

**Nous utilisons des matériaux haut de gamme tels que la ligne Pyralux et Dupont comprenant des conceptions complexes jusqu'à 11 couches sur des circuits full Flex et 24 couches pour nos circuits Flex-Rigide. Via enterrés, via borgnes, MicroVia.**

[contact@discomp.fr](mailto:contact@discomp.fr)

04 67 63 86 29



**DISCOMP**  
ELECTRONIQUE

# Nos capacités de production



- Production Chine & Europe de l'Est
- Séries – High-Tech & Prototypes

	FR4, FR4 HTg/Haute Fréquence/PTFE/SMI	FR4 HTg/Haute Fréquence/PTFE/Flex et Flex-Rigide/HDI
Nombres de couches :	Jusqu'à 12 couches	Jusqu'à 40 couches
Epaisseur du Circuit Imprimé :	0,3 à 3,2mm	0.1 à 5.0mm
Matériau :	FR4/FR4 HTg/CEM-3/Ceramic/SMI/Rogers/IS410/IS680	FR4 HTg/Polyimide/Ceramic/Rogers/Flex/Coverlay
Percage Min :	0,20mm	0,10 mm / Laser 0,075mm
Aspect ratio	Normal 8:1 / Max 10:1	Normal 10:1 / Max : 12:1
Type de Via :	Via traversants/ Via enterrés/Via borgnes/Via résiné	Via traversants/Via enterrés/Via borgnes/Via résiné/MicroVia/Microvia étagé, MicroVia skipped
Finitions :	HASL-Lead Free/ENIG/Electroplated Ni-Au/Immersion Tin/Immersion Silver/OSP/ENEPIG	HASL-Lead Free/Hard Gold fingers/Selective Hard Gold/ENIG/Chemical Tin

**Forts de 20 années d'expérience.**

**La qualité au rendez-vous de vos exigences d'industrialisation.**

**Qualité de nos produits certifiés : ISO, UL, IPC**

**Confiez-nous vos dossiers !**



[contact@discomp.fr](mailto:contact@discomp.fr)

04 67 63 86 29